公司代码:603061　　公司简称:金海通

天津金海通半导体设备股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.现金分红:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.38元(含税)。截至2026年3月10日公司总股本60,000,000股,公司拟合计派发的现金分红总金额为22,800,000.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例12.92%。

2.资本公积转增股本:公司以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股。截至2026年3月10日,公司总股本为60,000,000股,本次以资本公积转增股本后,公司的总股本为87,000,000股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。本次转增通过"资本公积——股本溢价"科目进行转增。

如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本数量发生变动的,则公司拟维持每股分配比例、每股资本公积转增比例不变,相应调整现金分红、转增股份总额,具体调整情况将另行公告,调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东会审议。

本次利润分配方案需提交2025年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金海通	603061	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘海龙	蔡亚茹
联系地址	上海市青浦区嘉松中路2188号	上海市青浦区嘉松中路2188号
电话	021-52279506	021-52279506
传真	022-89129719	022-89129719
电子信箱	jhtdesign@jht-design.com	jhtdesign@jht-design.com

2、报告期公司主要业务简介

(1)所属行业

公司主要产品为集成电路测试分选机,属于集成电路专用设备领域的测试分选设备,根据中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》(JR/T 0020—2024),隶属于专用设备制造业(行业代码:C35);根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),隶属于专用设备制造业下的半导体器件专用设备制造(行业代码:C3562)细分子行业。

(2)集成电路行业发展情况

①集成电路行业概况

半导体本质是一种导电性可控控制、介于绝缘体至导体之间的材料。从产业视角,半导体产业是围绕半导体包括材料、性能、应用等,发挥其优势进行科学研究、技术开发、功能设计、生产制造、集成应用与系统实施的全体系生产活动。从技术视角,半导体产业包括半导体材料研发与生产、半导体装备与工具的生产制造、半导体产品规划设计、半导体产品的生产及其全体系;从功能视角,半导体包括集成电路和分立器件。集成电路是半导体产业的核心,也是信息产业的基础和核心。集成电路应用领域覆盖了几乎所有的电子设备,是计算机、家用电器、消费电子、工业自动化、通信、汽车电子、航天等诸多产业发展的基础,也是改造和提升传统产业的核心技术。按其功能、结构的不同,集成电路可以分为模拟集成电路、数字集成电路和数模混合集成电路等。集成电路产业链主要包含芯片设计、晶圆制造、封装测试等。

公司的主要产品为集成电路行业中封装测试用的测试分选机,主要应用于集成电路生产流程中的后道工序封装测试。集成电路测试设备主要包括测试机、分选机和探针台等。测试机是检测芯片功能和性能的专用设备,分选机和探针台是分别将被测的芯片或晶圆与测试机的功能模块连接起来并实现批量自动化测试的专用设备。在晶圆检测环节,主要使用的测试设备为测试机和探针台,而在芯片设计验证、成品测试环节,主要使用的测试设备为测试机和分选机。

②集成电路专用设备行业简介

专用设备制造业是集成电路的基础产业和重要支撑,是完成晶圆制造和封装测试环节的基础,是实现集成电路技术进步的关键,在集成电路产业中占有极为重要的地位。集成电路生产线投资中设备投资占比较大,价值量较高。专用设备主要包含前道工序晶圆制造环节所需的光刻机、化学气相淀积(CVD)设备、刻蚀机、离子注入机、表面处理设备等;后道工序封装测试环节所需的切割减薄设备、键合封装设备等;测试环节所需的测试机、分选机、探针台等。在晶圆制造环节使用的设备一般被称为前道工艺设备,在封测环节使用的一般被称为后道工艺设备。这些设备的制造需要综合运用光学、物理、化学等科学技术,具有技术含量高、制造难度大、设备价值高等特点。

(3)行业发展情况

公司主要产品为集成电路测试分选机,属于集成电路专用设备领域的测试分选设备。半导体产业在历史发展过程中呈现了较强的周期性特征,这与国际贸易形势、下游应用市场需求波动以及国家产业政策等因素均存在一定的相关性。

在技术迭代、需求提升、场景渗透等因素的多重驱动下,2025年全球半导体行业延续增长态势,先进封装、AI及高性能计算等需求的增长给半导体设备带来广阔的市场空间。半导体行业协会(SIA)数据显示,2025年全球半导体销售额达到了,917亿美元,较2024年同比增长25.6%,创历史新高。此前世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测,2025年全球半导体市场规模预计同比增长22.5%。上述驱动因素动能的持续释放,将推动未来几年全球半导体行业持续快速发展。

特别是随着先进封装、AI算力芯片等的发展,相关芯片测试的复杂度在攀升,芯片测试总耗时大幅提高,对高端测试资源的需求在快速增加;与此同时,相关芯片的测试在温度控制、热管理效率及动态适配能力等方面,对半导体测试分选设备提出了更高的要求。半导体测试设备公司已进入快速发展新阶段。

未来,集成电路产业将继续向更具精细化的模式发展,随着集成电路产业进一步精细化分工,为确保产品质量、生产效率和生产稳定性,半导体测试设备企业需要与集成电路设计企业、晶圆制造企业、封装测试企业经过长时间的协作、磨合,提供符合客户使用习惯和生产标准的定制化测试方案开发,产业链协同效应将极大提升新型设备。同时,测试任务的复杂性对分选机设备不断提出更高要求,测试分选机设备将呈现高效率、高稳定性、柔性化及多功能的发展趋势。

(3)公司主营业务概况

自成立以来,公司一直专注于全球半导体芯片测试设备领域,同时致力于以高端智能装备核心技术助力我国半导体行业发展,以其自主研发的测试分选机产品加快半导体测试设备的进口替代。

公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售,客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工、IDM企业(半导体设计制造一体化厂商)、芯片设计公司等。公司产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度,产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。

公司产品集成电路测试分选机在客户公司(半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业、芯片设计公司等)所分选的芯片品类高在单位时间产量、消费电子、智能互联、5G、人工智能等领域中应用的芯片(公司产品应用于某类芯片测试分选的具体情况系客户公司经营行为)。

(4)公司主要产品介绍

公司深耕平移式测试分选机领域,产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为EXCEED-6000系列、EXCEED-8000系列、EXCEED-9000系列、SUMMIT系列、COLLIER系列等不同系列的测试分选机。

公司产品测试分选机涉及到光学、机械、电气一体化的创新集成,可以精准模拟芯片真实使用环境,并实现多工位并行测试,其UPH可达20,000颗,Jam rate低于1/200,000,可测试芯片尺寸范围可涵盖2*2mm至125*170mm,可模拟最低-55℃,最高200℃等各种极端温度环境。

(5)公司主要经营模式

①盈利模式

公司为客户提供集成电路测试分选专用设备及备品备件并获取收入和利润。报告期内,公司主营业务收入主要来源于EXCEED-6000系列、EXCEED-8000系列、EXCEED-9000系列,其他系列等各类型测试分选机产品及相关配件的销售。

②采购模式

公司采购采取询价方式,综合考虑供应商产品品质、价格、交付能力等多方面因素选择供应商。公司综合客户订单情况、行业趋势等因素,按照"以销定产"和"安全库存"的形式确定生产计划以及物料需求计划。公司根据每年的供应商交货良率进行评估,结合采购需求及供应商的产品质量和交货能力,与供应商协商询价比选,确定各供应商的采购数量和采购价格等,最终确定采购订单并执行采购。报告期内公司主要供应商保持相对稳定。

③生产模式

公司产品具有较强的定制化属性,公司主要实行"以销定产"和"安全库存"的生产模式,结合库存和市场情况安排生产计划,并采用核心产品自主生产,部分成熟产品委托外协的方式进行生产加工。

④销售模式

公司主要的销售模式有直销模式和代理模式,客户群体主要分布在中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等半导体封装、加工产业发达的国家和地区,其中,境内销售以直销模式为主,境外销售主要有直销和代理模式。对于直销模式与代理模式,主要由公司与终端客户直接签署销售合同。代理模式下,待客户验收设备并支付货款后,公司根据代理协议支付代理商相应佣金。公司具有完善的售后服务体系,公司在境内外设立了子公司或在当地成立办事处为及时响应客户需求。

⑤生产模式

公司主要采用自主研发的模式。公司研发人员主要分为机械类、电气类、软件及算法类、工艺类等多个方向,研发工作按具体研发项目细分为不同项目小组分别进行。公司对研发项目的立项、审批、执行等流程进行了相应规定,研发项目完成立项、审批程序后,形成技术方案;不同研发小组根据技术方案分别进行新产品相关模块设计,并根据设计完成新产品样品,通过的模块测试与综合测试之后,进行试生产验证。在实际生产环境测试中,研发小组成员会根据反馈情况持续完善产品性能,直至新产品正式定型,并投入量产。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元/币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,149,652,156.84	1,598,545,608.03	34.47	1,584,983,206.39
归属于上市公司股东的净资产	1,614,293,008.86	1,316,232,759.41	22.64	1,398,865,603.97
营业收入	698,176,005.39	406,666,312.61	71.68	347,234,545.48
利润总额	196,800,497.09	84,850,967.53	131.94	92,726,544.39
归属于上市公司股东的净利润	176,525,276.68	78,481,491.79	124.93	84,794,006.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,048,696.02	67,736,509.73	152.52	69,465,975.89
经营活动产生的现金流量净额	127,809,505.47	58,986,103.16	116.68	-48,361,309.85
加权平均净资产收益率(%)	12.22	6.01	增加6.21个百分点	6.84
基本每股收益(元/股)	3.06	1.35	126.93	1.47
稀释每股收益(元/股)	3.04	1.35	125.19	1.47

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元/币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	128,608,637.26	178,810,367.32	174,179,734.83	216,580,265.89
归属于上市公司股东的净利润	25,658,510.03	50,347,029.65	48,975,719.98	51,544,018.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,309,116.01	49,504,980.56	47,665,468.08	49,569,031.37
经营活动产生的现金流量净额	5,983,247.41	10,593,454.00	33,374,315.90	77,858,488.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,806
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,208
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
崔宇峰	0	8,511,132	14.19	8,511,132	质押	2,550,000	境内自然人
宁波旭诺创业投资基金管理合伙企业(有限合伙)	0	5,369,685	8.95	0	质押	1,680,000	其他
龙波	0	5,344,146	8.91	5,344,146	质押	530,000	境内自然人
南通华泓投资有限公司	0	3,958,890	6.60	3,958,890	无	0	境内非国有法人
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-916,000	3,042,471	5.07	0	无	0	其他
钟晓	500,000	2,870,000	4.78	0	无	0	境内自然人
天津金海通半导体设备股份有限公司-2026年员工持股计划	1,734,770	1,734,770	2.89	0	无	0	其他
浙江金浦新潮创业投资合伙企业(有限合伙)	-677,400	1,719,963	2.87	0	无	0	其他
秦维辉	72,200	966,842	1.59	0	无	0	境内自然人
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	727,781	734,581	1.22	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.崔宇峰、龙波为公司的控股股东,实际控制人,崔宇峰与龙波为一致行动人; 2.上海金浦动投资有限公司为有限合伙人持有上海金浦,浙江金浦的财产份额,上海金浦,浙江金浦已持有公司的合伙人上海裕熙企业管理中心(有限合伙)、上海金浦新潮私募基金管理有限公司,上海裕熙动投资有限公司; 3.除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5、公债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:603061　证券简称:金海通　公告编号:2026-024

天津金海通半导体设备股份有限公司关于增加预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次关联交易对公司的影响:公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需,有利于公司业务的发展,且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形,公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年3月9日,天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于增加预计2026年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事专门会议审议后认为:本次日常关联交易事项涉及的交易价格遵循市场化原则,没有损害公司和股东权益的情形,符合法律、法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定,一致同意将以上议案提交董事会审议,关联董事应当回避表决。

公司审计委员会审议后认为:本次关联交易预计符合公司业务的发展需要,交易价格公允,对公司经营活动及财务状况不存在不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,一致同意将以上议案提交董事会审议,关联董事应当回避表决。

2026年3月10日,公司第二届董事会第二十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于增加预计2026年度日常关联交易的议案》,关联董事吴华闽回避表决。

公司董事会审议后认为:本次日常关联交易事项符合公司日常生产经营实际情况,为公司正常经营所需,有利于公司业务的发展,且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形,公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本次预计关联交易金额总额未超过本公司最近一期经审计净资产的5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

(二)本次增加2026年度日常关联交易预计金额和类别

为满足公司日常经营发展需要,公司拟新增与关联方南通华达微电子集团股份有限公司的日常关联交易事项,交易内容主要为公司向关联方出售半导体测试分选机及相关备品备件,本次预计新增日常关联交易金额合计不超过2,000万元,公司2026年度日常关联交易预计金额从17,440万元上升至19,440万元,具体情况如下:

关联交易类别	关联方名称	2026年原预计额度(万元)	2026年内原调用后的预计额度(万元)注2	前次增加预计额度(万元)	前次增加后2026年预计额度(万元)	2025年实际发生金额(经审计)(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	通富微电子股份有限公司	1,000	2,700	增加1,000	3,700	3,700	3,213.76
向关联方销售商品	苏州通富超威半导体有限公司	500	100		100	100	75.61
向关联方销售商品	南通通富微电子有限公司	3,000	1,000		1,000	1,000	684.58
向关联方销售商品	TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.	2,100	1,200		1,200	1,200	862.56
向关联方销售商品	合肥通富微电子有限公司	500	500		500	600	559.67
向关联方销售商品	通富通科(南通)微电子有限公司	1,000	2,600	增加500	3,100	3,000	2,529.15
向关联方租赁房产	上海新朋实业股份有限公司	1,440	1,440		1,440	1,440	1,045.61
小计		9,540	9,540	增加1,500	11,040	11,040	8,970.94

注1:上述关联交易在关联交易预计金额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂,苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科(南通)微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司,前述6家公司为同一控制下的不同关联方,关联交易金额可以内部调剂;

注2:本列为公司根据2025年1-10月实际发生的关联交易金额并结合公司经营需要,在关联交易预计总额范围内,对在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂后的金额。

注3:上表内公司根据2025年1-12月实际发生的关联交易金额并结合公司经营需要,在关联交易预计总额范围内,对在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂后的金额。

注4:上表中2025年实际发生金额均为含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

1.南通华达微电子集团股份有限公司

(1)关联人的基本情况

公司名称	南通华达微电子集团股份有限公司
统一社会信用代码	913206001382898079X
公司类型	股份有限公司(非上市,自然人投资或控股)
法定代表人	石明达
注册资本	2,000万元
成立日期	1990年10月11日
住所及主要办公地点	南通市紫琅路98号
主营业务	生产销售半导体分立器件,集成电路电子应用产品;经营本企业自产产品,成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);矿产品销售;自有房屋租赁,停车场服务(污水污气机构经营);依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联人最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元

项目	2025年12月31日(未经审计)	2026年1月31日(未经审计)
总资产	3,999,513,885.12	4,930,440,989.03
净资产	3,650,192,048.42	4,194,343,472.08
项目	2025年度(未经审计)	2026年1月31日(未经审计)
营业收入	299,577,466.2	31,424,567.73
净利润	56,922,696.86	544,161,573.56

(2)与公司的关联关系

(3)关联方履约能力

公司与南通华达微电子集团股份有限公司的日常关联交易事项,交易内容主要为公司向关联方出售半导体测试分选机及相关备品备件,本次预计新增日常关联交易金额合计不超过2,000万元,公司2026年度日常关联交易预计金额从17,440万元上升至19,440万元,公司与关联方的关联交易预计金额总额未发生变动,公司与关联方的关联交易预计金额从17,440万元上升至19,440万元,公司与关联方的关联交易预计金额总额发生变动,但公司与关联方的关联交易预计金额总额仅占公司2025年度经审计营业收入的2.78%,公司与关联方的关联交易预计金额总额仅占公司2026